



Weichlöten · Hartlöten · Hochtemperaturlöten
Soldering · Brazing · High-Temperature Brazing

Einladung

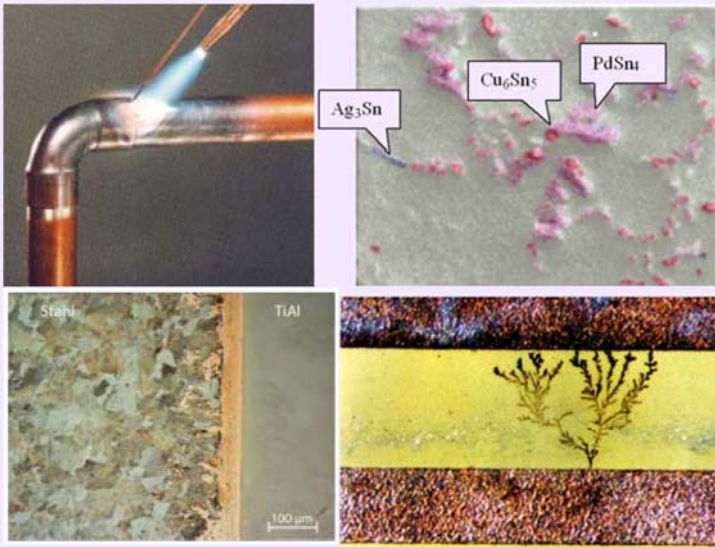
11. Mitgliederversammlung

und

7. Löttechnisches Forum

19. Juni 2009

Technische Universität Berlin



In guter Tradition veranstaltet die Fachgesellschaft „Löten“ im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. ihre jährliche Mitgliederversammlung in Verbindung mit einem Löttechnischen Forum.

Alle Mitglieder und an der Fachgesellschaft Interessierte sind herzlich zur Teilnahme an der 11. Mitgliederversammlung und am 7. Löttechnischen Forum am 19. Juni 2009 an die Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Fachgebiet Füge- und Beschichtungstechnik, eingeladen.

Frei nach dem Motto „Aus der Fachgesellschaft für die Fachgesellschaft“ informieren Partner aus Industrie und Forschung über Aktuelles aus dem Bereich des Hart- und Hochtemperatur- sowie des Weichlötens und laden zum fachlichen Dialog ein.

Sieben Fachvorträge bieten Anwendern, Herstellern, Dienstleistern und Instituten die Möglichkeit zum direkten Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

Die Fachgesellschaft „Löten“ heißt Sie in Berlin willkommen und freut sich auf Ihre Teilnahme.

Düsseldorf, im Mai 2009

Dr.-Ing. Hartmut Schmoor

Vorsitzender der Fachgesellschaft „Löten“ im DVS

Veranstaltungsort

Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Fachgebiet Füge- und Beschichtungstechnik, Pascalstr. 8 – 9, 10587 Berlin

Produktionstechnisches Zentrum, Raum 002

Anreise

Informationen zur Anreise finden Sie unter:

<http://www.iwf.tu-berlin.de/kontakt/>

Übernachtung

Folgende Hotels werden empfohlen:

- Hotel Econtel
Sömmeringstr. 24-26, 10589 Berlin
Telefon 030/34681-0, info@berlin.econtel.de
- Hotel Adrema
Gotzkowskistr. 20/21, 10555 Berlin
Telefon 030/20213300, www.gold-inn.de
- Weitere Hotels unter:
www.hrs.de, www.hotel.de etc

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise.

7. Löttechnisches Forum – Programm

- 10.00 h **11. Mitgliederversammlung**
- 11.10 h **Begrüßung zum 7. Löttechnischen Forum**
- 11.15 h Sebastian Weis, Bernhard Wielage, Ina Hoyer, Technische Universität Chemnitz, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe: **Löten von Aluminium-Matrix-Verbundwerkstoffen (AMC)**
- 11.45 h Ina Hoyer, Bernhard Wielage, Technische Universität Chemnitz, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe: **Neue Entwicklungen auf dem Gebiet des Hochtemperaturlötens mit Eisenbasisloten**
- 12.15 h Johannes Wilden, Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Fachgebiet Füge- und Beschichtungstechnik: **Innovative Werkstoff- und Prozesskonzepte für die Fügetechnik**
- 12.45 h **Mittagspause**
- 13.30 h Heinz Wohlrabe, Technische Universität Dresden, Zentrum für Mikrotechnische Produktion: **Qualitätsoptimierung von Weichlötprozessen durch Anwendung statistischer Methoden; Möglichkeiten, Grenzen, Anwendungsbeispiele**
- 14.00 h Gerjan Diepstraten, Cobar Europe BV, Mitglied der Balver Zinn Gruppe, Breda/NL: **Selektivlöten und Lotbadmanagement**
- 14.30 h Markus Detert, Universität Magdeburg, Institut für Mikro- und Sensorsysteme, Lehrstuhl Mikrosystemtechnik: **Löten – Verbindungstechnologie heterogener Funktionssysteme**
- 15.00 h Wolfgang H. Müller, Technische Universität Berlin, Institut für Mechanik: **Lebensdauerberechnung und Ausfallcharakteristiken bei Weichloten**
- 15.30 h **Ende der Veranstaltung**

Fachgesellschaft „Löten“ im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Aachener Str. 172, D-40223 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 / 1591 – 0, Fax: +49 (0) 211 / 1591 – 200
E-Mail: fg-loeten@dvs-hg.de, Web: www.dvs-loeten.de/loeten



Anmeldung per Fax: +49(0)211 / 1591-200
(Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte melden Sie sich bis spätestens zum 11. Juni 2009 an)

Name: _____ Frau Herr
Vorname: _____
Titel: _____
Firma/Institut: _____
Abteilung: _____
Adresse: _____
Tel.: _____ Fax: _____
E-Mail: _____

Ich bin / Wir sind Mitglied der Fachgesellschaft „Löten“: ja (Mitgliedsnummer:) nein

Für Mitglieder der Fachgesellschaft ist die Teilnahme am 7. Löttechnischen Forum kostenfrei. Nichtmitglieder können gegen Entrichtung einer Teilnahmegebühr in Höhe von € 130,00 pro Teilnehmer ebenfalls teilnehmen.

Hiermit melde ich mich / uns für die Teilnahme verbindlich an:
 an der 11. Mitgliederversammlung
 am 7. Löttechnischen Forum

Ich / Wir werden mit _____ Personen teilnehmen.
Die Teilnahmegebühr überweise/n ich / wir nach Rechnungsstellung umgehend auf das dort angegebene Konto.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Eine schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung über die Teilnahmegebühr gehen Ihnen nach Eingang der Anmeldung zu.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Plätze werden nach Eingangsdatum vergeben. Wir bitten um Ihr Verständnis.